13. Berliner Technologieforum

25. Mai 2023

Geboostert für die Elektronikfertigung der Zukunft?

Nachhaltigkeit, Prozessoptimierung und Digitalisierung

ASYS GROUP · kolb · ASMPT enabling the digital world · ZEVAC

rehm THERMAL SYSTEMS · mtm RUHR ZINN · CHRISTIAN KOENEN GMBH HIGHTECH STENCILS · SIEMENS

VLIESSTOFF KASPER · ate care automatic basic equipment · BALVER ZINN®

Jetzt anmelden!

https://www.rehm-group.com/aktuelles/termine/detail/13-berliner-technologieforum.html

Nachhaltigkeit

Im ersten Block der Veranstaltung werden prozess- und materialabhängige Lösungsansätze zum Recycling und zur Reinigung sowie neue Leiterplattentechnologien zur CO_2-Reduktion in der Elektronikenfertigung vorgestellt.

Prozessoptimierung

Optimales Schablonendesign und ein präziser Lotpastendruck bilden die Grundlage für eine defektfreie und somit ressourceneffiziente Elektronikfertigung. Informieren Sie sich in diesen Vorträgen über Neuerungen im Bereich dieser wichtigen SMD-Fertigungsschritte.

Digitalisierung

Zu diesem nach wie vor wichtigen Innovationstreiber in unserer Branche werden etablierte Kommunikationsschnittstellen präsentiert sowie innovative zukünftige Nutzungsszenarien im Bereich der Digitalisierung anhand aktueller Forschungsvorhaben vorgestellt.